

## FORMAPad® GI-5100

PAD Térmico  
Líquido-Gel



### Descrição

O FORMAPad® GI-5100 é um material de gerenciamento térmico mono-componente, que foi especialmente formulado para oferecer excelente conformabilidade e baixíssimo nível de sangramento, aliado a um comportamento com bom nível de adesão às superfícies de contato. Ele pode ser dispensado automaticamente e através de processos serigráficos, o que facilita seu manuseio no ambiente fabril. Além disso, oferece uma excelente estabilidade mecânica em condições de temperatura ambiente variadas, aliada a uma alta condutividade térmica e baixa resistência.



### Características

- Ultra conformação às irregularidades das superfícies de contato
- Pode ser aplicado como uma Pasta Térmica, com ou sem o auxílio de processo serigráfico
- Alta Condutividade Térmica – W/m.k
- Pasta com bom nível de adesão
- Possibilidade de aplicação em camadas inferiores a 0,025mm



### Aplicações

- Módulos IGBT
- Luminárias de LED
- Eletrônicos Automotivos
- Transistores, Diodos, CPUs, etc

# FORMAPad® GI-5100

**CELERA**  
Passion for Technique

## Propriedades Típicas

Propriedade	Norma	Unidade	Valores
Cor	-	-	Cinza
Viscosidade	-	PaS	550
Condutividade Térmica	ASTM D5470	W/m.k	2,6
Temperatura de Operação	-	°C	-55 a +205
Validade a 25 °C	-	-	5 anos
Resistência Térmica	ASTM D5470	C-in <sup>2</sup> /W	0,01
Densidade	ASTM D792	g/cm <sup>3</sup>	2,2
Fator de Dissipação	ASTM D150	1KHz	0,1277
Rigidez Dielétrica	ASTM D149	Kv	2,8
Resistividade Volumétrica	ASTM D257	Ohm.m	10 <sup>9</sup>